

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 10 月 6 日(06.10.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/158067 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 79/04 (2006.01) *C08J 5/24* (2006.01)
B32B 15/08 (2006.01) *C08K 3/00* (2006.01)
B32B 15/092 (2006.01) *C08L 63/00* (2006.01)
C08G 59/40 (2006.01) *H05K 1/03* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/054855
- (22) 国際出願日: 2016 年 2 月 19 日(19.02.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-072691 2015 年 3 月 31 日(31.03.2015) JP
- (71) 出願人: 三菱瓦斯化学株式会社(MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒1008324 東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小林 宇志(KOBAYASHI, Takashi); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP). 高野 健太郎(TAKANO, Kentaro); 〒1258601 東京都葛飾区新宿 6 丁目 1 番 1 号 三菱瓦斯化学株式会社 東京テクノパーク内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 稲葉 良幸, 外(INABA, Yoshiyuki et al.); 〒1066123 東京都港区六本木 6-10-1 六

本木ヒルズ森タワー 23 階 TMI 総合法律事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: RESIN COMPOSITION FOR PRINTED WIRING BOARD, PREPREG, RESIN COMPOSITE SHEET, AND METAL FOIL-CLAD LAMINATE PLATE

(54) 発明の名称: プリント配線板用樹脂組成物、プリプレグ、樹脂複合シート及び金属箔張積層板

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a resin composition that makes it possible to obtain a printed wiring board having not only heat resistance and flame retardancy but also excellent heat resistance under moisture absorption. Provided is a resin composition that is for a printed wiring board and that contains: a cyanate ester compound (A) obtained by cyanating a naphthol-dihydroxynaphthalene aralkyl resin or a dihydroxynaphthalene aralkyl resin; and an epoxy resin (B).

(57) 要約: 耐熱性、難燃性を有するだけでなく、吸湿耐熱性にも優れるプリント配線板を実現し得る樹脂組成物の提供を目的とする。当該樹脂組成物は、ナフトール-ジヒドロキシナフタレンアルキル樹脂又はジヒドロキシナフタレンアルキル樹脂をシアネート化して得られるシアン酸エステル化合物 (A) と、エポキシ樹脂 (B) とを含有するプリント配線板用樹脂組成物である。



WO 2016/158067 A1